

Nuvo-7000LPシリーズ

6×GbEポート、MezIO™インターフェース、およびロープロファイルシャーシを搭載の
 インテル®第8世代Coffee Lake Core™ i7/i5/i3ファンレスコンピュータ



主な機能

- インテル® 第8世代コア™ iヘキサコア35W/65W LGA1151 CPU
- ホットスワップ対応2.5インチHDD/SSDトレイを備えた薄型シャーシ
- 容易な機能拡張のためのMezIO™インターフェース
- 堅牢、広い同温度範囲(-25℃~70℃)でのファンレス動作
- 9.5 KBのジャンボフレームをサポートする最大6×GbEポート
- NVMe SSD または Intel® Optane™ メモリをサポートするM.2 2280 M キーソケット (Gen3×4)
- 4倍速USB 3.1 Gen2ポートと4倍速USB 3.1 Gen1ポート
- 4K2K解像度をサポートするVGA/DVI/DPトリプル独立ディスプレイ

概要

最大6コア/12スレッドのアーキテクチャを搭載したIntel®8th-Gen Core™iプロセッサを搭載したNeosys Technologyの2018年フラッグシップ堅牢ファンレス組み込みコンピュータです。

Nuvo-7000LPシリーズは、79mmのロープロファイルシャーシで同等レベルの堅牢性と汎用性を特徴とするNuvo-7000シリーズの派生品です。効果的なファンレス設計、独自のMezIO™インターフェース、および多数のオンボードI/Oインターフェースに加えて、前面からアクセス可能なホットスワップ対応のHDD/SSDトレイを1つ備えています。内部SATAポート付き。また、最先端のM.2 NVMe SSDテクノロジーを利用して2000MB/s以上のディスク読み書き速度を実現、Intel® Optane™メモリをインストールしてシステムの高速化を図ります。

Neosys Nuvo-7000LPシリーズは、最新のIntelヘキサコアCPU、高速I/Oインターフェース、超高速ディスクアクセス、および柔軟なストレージ構成を統合して、高性能で堅牢な組み込みコンピュータを形成します。さらに、内蔵のMezIO™インターフェースを利用して、アプリケーション固有のI/O用のモジュールを追加することもできます。

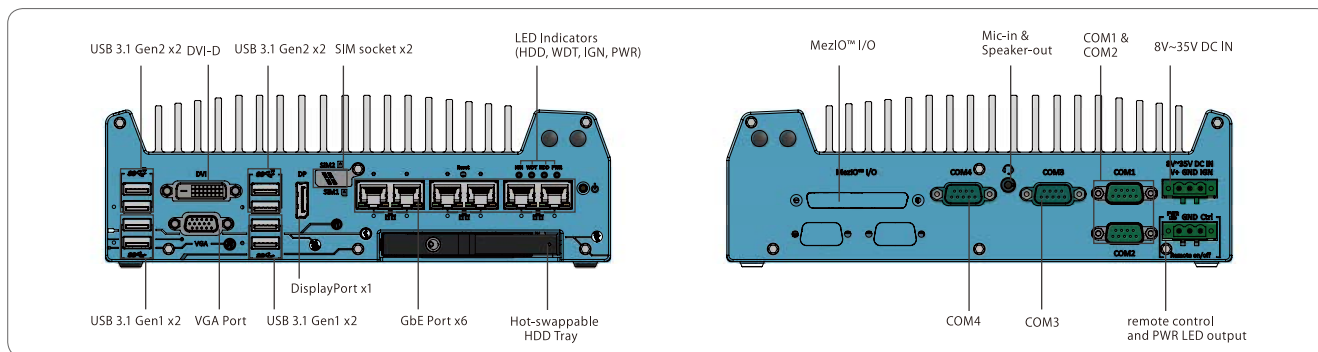
仕様

システムコア		内蔵拡張バス	
プロセッサ	Intel® 第8世代 Coffee Lake 6-core CPU (LGA1151 socket, 35W/65W TDP) 対応 - Intel® Core™ i7-8700/ i7-8700T - Intel® Core™ i5-8500/ i5-8500T - Intel® Core™ i3-8100/ i3-8100T - Intel® Pentium® G5400/ G5400T - Intel® Celeron® G4900/ G4900T	Mini PCI-E	1×内蔵SIMソケット付フルサイズ mini PCIエクスプレスソケット (mSATA付mux)
チップセット	Intel® Q370 Platform Controller Hub	M.2	1×フロントアクセス可能なSIMソケット付M.2 2242 B キーソケット
グラフィクス	Integrated Intel® UHD Graphics 630	拡張可能なI/O	1× Neosys MezIO™用 MezIO™拡張ポート
メモリ	最大64 GB DDR4 2666/2400 SDRAM (2 SODIMM スロット)	電力供給	
AMT	AMT 12.0対応	DC入力	1× 8~35VDC DC入力用の3ピン プラガブル端子台
TPM	TPM 2.0 対応	リモートコントロール & ステータス出力	1× リモートコントロールおよびPWR LED出力用の3ピン プラガブル端子台
I/O インターフェース		メカニカル	
イーサネットポート	2× I219 および I210 ギガビットイーサネットポート (Nuvo-7002LP) 6× I219 および 5× I210 ギガビットイーサネットポート (Nuvo-7006LP)	寸法	240 mm (W) × 225 mm (D) × 79 mm (H)
PoE+	ポート3~ポート6 総電力バジェット 100W向け IEEE 802.3at PoE+ (オプション)	重量	3.1 kg
USB	4× USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) ポート 4× USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) ポート	取付	壁取り付け (標準) およびDINレール取り付け (オプション)
ビデオポート (Integrated Graphics)	1920 × 1200解像度をサポートする1× VGAコネクタ 1920 × 1200解像度をサポートする1× DVI-Dコネクタ 4096 × 2304解像度をサポートする1× DisplayPortコネクタ	環境	
シリアルポート	2× ソフトウェアプログラマブルな RS-232C/422/485 ポート (COM1/ COM2) 2× RS-232C ポート (COM3/ COM4)	動作温度	35W CPUの場合 -25℃ ~ 70℃ ** 65W CPUの場合 -25℃ ~ 70℃ */** (35W TDPとして構成) -25℃ ~ 50℃ */** (65W TDPとして構成)
オーディオ	マイク入力およびスピーカ出力用 1×3.5mmジャック	保管温度	-40℃ ~ 85℃
ストレージインターフェース		湿度	10%~90%、結露なきこと
SATA HDD	1× フロントアクセス可能、ホットスワップ対応 2.5インチHDD/SSDトレイ 1× 2.5インチHDD/SSDインストール用の1×内部SATAポート、RAID 0/1	振動	操作中、MIL-STD-810G、方法514.6、カテゴリ4
M.2	1× NVMe SSD または Intel® Optane™ メモリインストール用 M.2 2280 M キーソケット	衝撃	操作中、MIL-STD-810G、方法516.6、手順I、表516.6 II
mSATA	1× フルサイズmSATAポート (mini-PCIe付きmux)	EMC	EN55032およびEN55035に準拠したCE/FCCクラスA

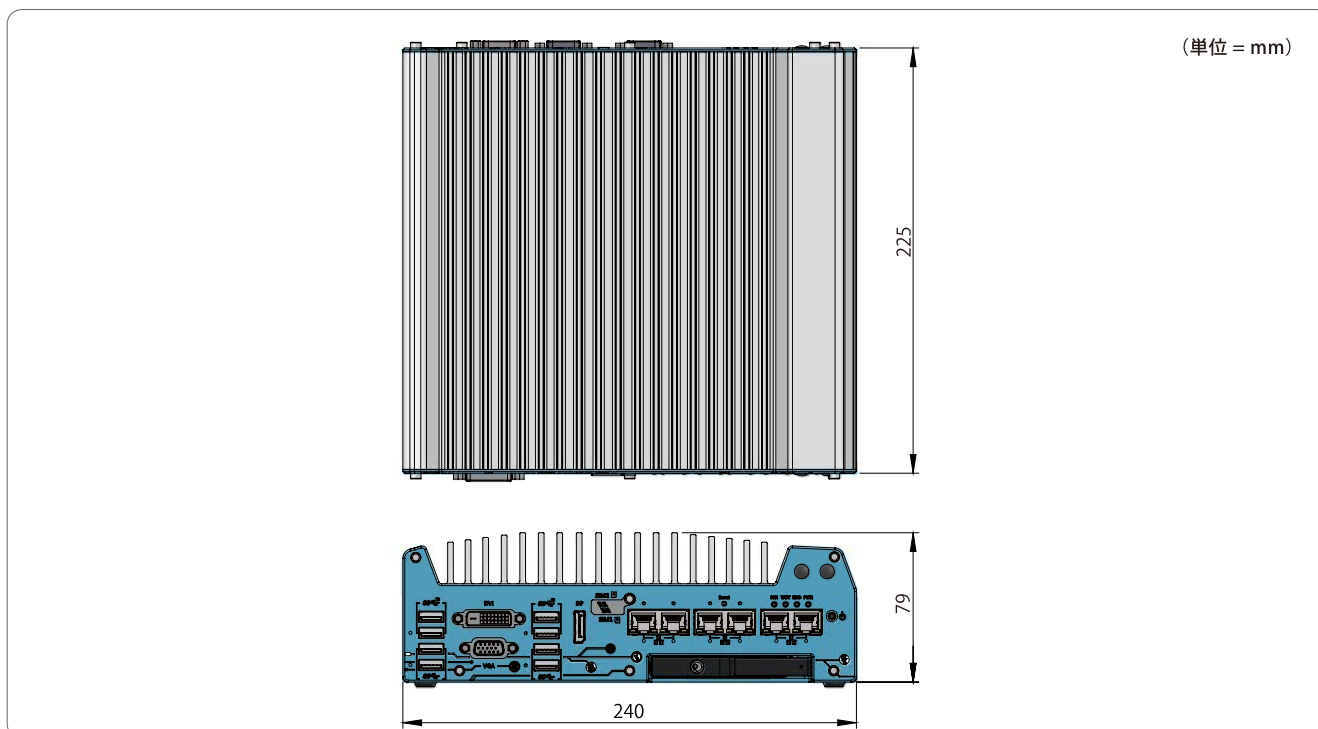
* 65Wモードで動作するi7-8700の場合、最高動作温度は50℃に制限され、持続的な全負荷がかかるとサーマルスロットルが発生する可能性があります。ユーザはより高い動作温度を得るためにBIOSでCPUパワーを設定することができます。

** 氷点下の動作温度では、ワイド温度HDDまたはSSD (Solid State Disk) が必要です。

外 観



寸 法



オーダー情報

Model No.	Product Description
Nuvo-7002LP	2×GbEポート、MezIO™インターフェース、およびロープロファイルシャーシ搭載のインテル®第8世代Coffee Lake Core™ i7/i5/i3ファンレスコンピュータ
Nuvo-7006LP	6×GbEポート、MezIO™インターフェース、およびロープロファイルシャーシ搭載のインテル®第8世代Coffee Lake Core™ i7/i5/i3ファンレスコンピュータ
Optional IEEE 802.3at PoE+ for GbE ports 3 ~ 6	